

# WB接合断面の3D構造解析

様々なスケール(SEM~TEM)の3D構造解析に対応致します！

FIB  
(FB2100:日立)

FIB-SEM/EDX/EBSD/STEM  
(NB5000:日立)



(NB5000)

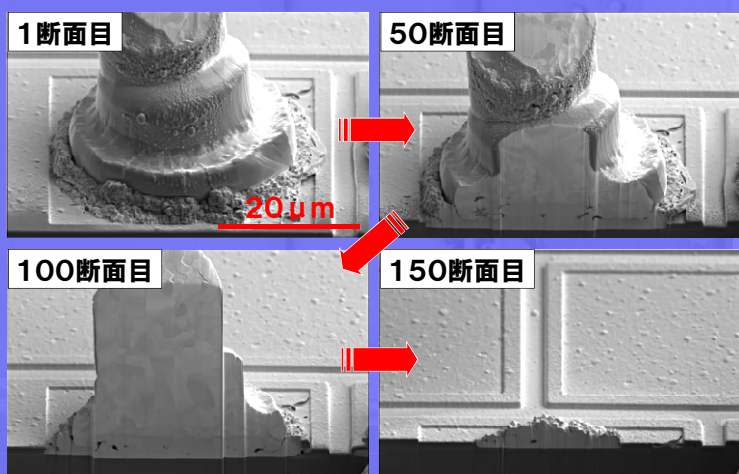
STEM/EDX/EELS  
(HD2300:日立)



(HD2300)

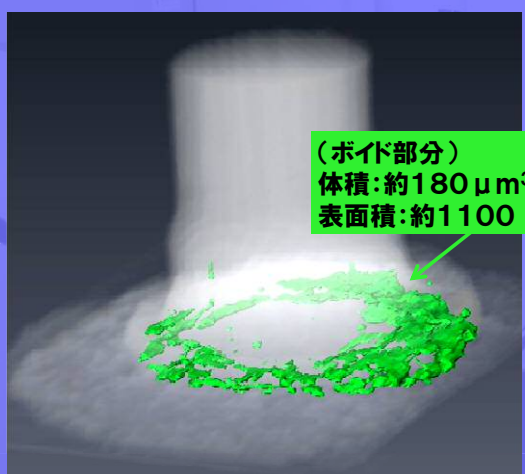
例えば  
こんなことができます！

## FIB-SEMを用いた3D構造解析(WB接合断面)



(連続断面SEM観察像)

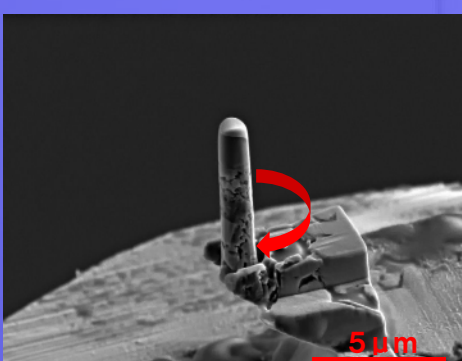
画像  
解析



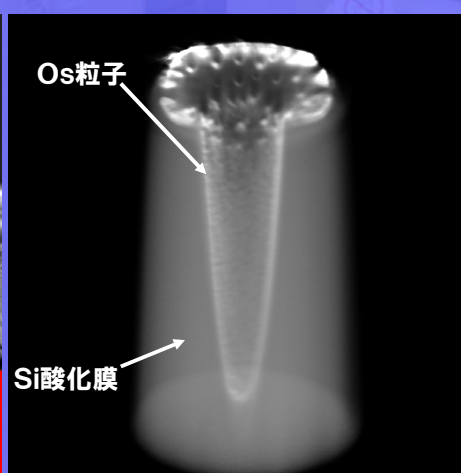
(ポイド部分)  
体積:約180 μm<sup>3</sup>  
表面積:約1100 μm<sup>2</sup>

(3D再構築結果)

## STEMトモグラフィを用いた3D構造解析(微細孔側壁の微粒子)

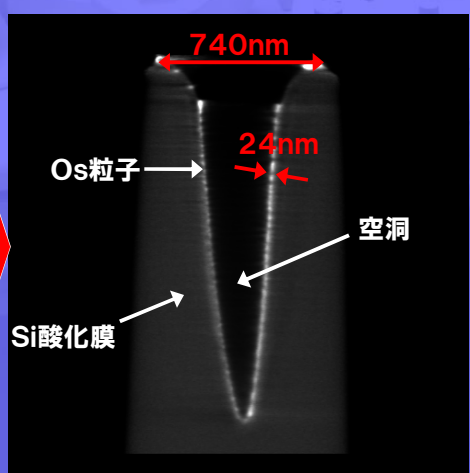


FIBにてマイクロピラー状試料を作成し、  
1~2° 刻みで連続回転STEM観察像  
を取得



(3D再構築結果)

任意  
断面を  
取出し



(任意断面の測長結果)